

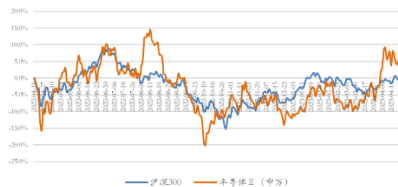
芯片交期下滑延续，价格或有企稳趋势

相关研究：

- 1.《子板块走势分化，分立器件下游需求高景气延续》 2022.03.15
- 2.《市场分化延续，汽车业务及HPC需求平稳》 2022.07.25
- 3.《全球芯片交期缩短，细分产品交期略有分化》 2022.12.26

行业评级：增持

近十二个月行业表现



%	1个月	3个月	12个月
相对收益	9.24	10.1	6.0
绝对收益	13.1	9.0	5.5

注：相对收益与沪深300相比

分析师：王美瑞

证书编号：S0500523010001

Tel: (8621) 50293694

Email: wangwr2@xcsc.com

地址：上海市浦东新区银城路88号
中国人寿金融中心10楼湘财证券研究所

核心要点：

Q1 智能手机、PC 出货量持续下滑

2023Q1 传统消费电子领域需求依旧不振，Canalys 的数据显示 Q1 全球智能手机市场的出货量同比减少 12%；IDC 统计数据显示，Q1 全球 PC 出货量同比下滑 29.32%。通信、计算机及消费电子在半导体下游需求中的占比合计超过 85%，芯片交期受下游主流需求疲软影响持续下调。

芯片及半导体元器件交期下降，但价格或企稳

Susquehanna Financial Group 统计数据显示 2023 年 3 月，全球芯片交货周期相较于 2022 年 5 月缩短超过一个月。细分市场领域，富昌电子的统计数据显示，相较于 2022Q4 模拟芯片交期趋于平稳；中高端 MCU 及蓝牙模块的交期持续缩短，但部分产品价格有企稳回升趋势。分立器件产品中，低压 Mosfet 部分产品交期有下滑趋势，高压 Mosfet 及 IGBT 交期仍稳定在 40 周左右，分立器件价格季环比基本持平。车规元器件受下游需求驱动，交期依旧较长，价格季环比持平。

投资建议

传统消费电子领域需求复苏预期转强，但销售端尚未出现显著改善，行业龙头企业仍位于主动去库存、削减资本开支阶段，建议紧密关注消费电子终端需求的变动，上游半导体设计龙头的库存及成本变动。汽车智能化渗透率提升及出口增长驱动板块需求稳步增长，建议关注车规级 MOSFET 及 SIC 功率器件的国产化进程。2023 年数字化建设在多领域的稳步推进及人工智能大数据模型的多领域商用，为产业链发展带来新动能，预期将持续提振传感器、CPU、GPU、存储等多种半导体硬件的市场需求。建议持续关注半导体行业，维持行业增持评级。

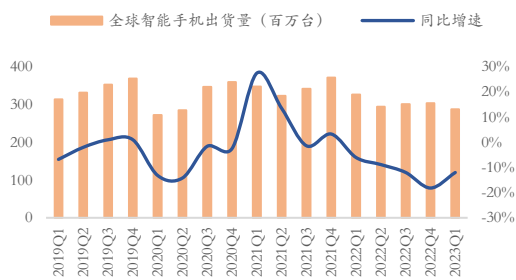
风险提示

下游市场需求不及预期；研发进展不及预期；宏观政策变化不及预期。

1 Q1 智能手机、PC 出货量持续下滑

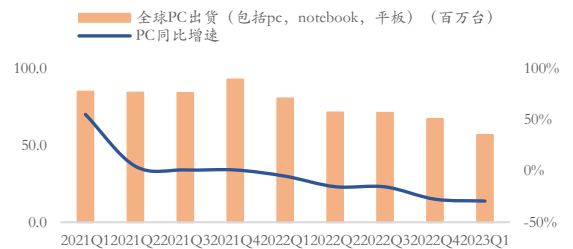
2023Q1 传统消费电子领域需求依旧不振，全球智能手机、PC 的销量年同比延续下滑态势。根据 Canals 的数据显示，Q1 全球智能手机市场的出货量同比减少 12%，主要系需求端疲软所致。IDC 统计数据显示，Q1 全球 PC 出货量同比下滑 29.32%。全球新能源销量仍保持上行态势，Cleantechnica 统计数据显示，2023 年前两个月全球新能源汽车销量同比增长 128.9%；但车规电子需求尚处于成长阶段，占半导体下游需求的比例不足 10%，导致半导体细分市场需求出现分化。

图 1 全球智能手机销量



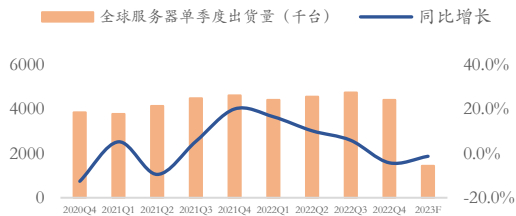
资料来源：Counterpoint、Digitimes、湘财证券研究所

图 2 全球 PC 销量



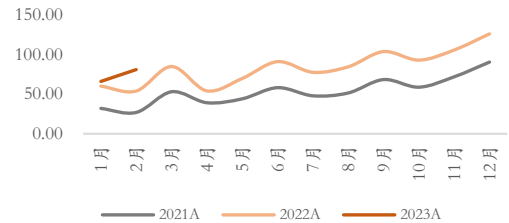
资料来源：IDC、湘财证券研究所

图 3 全球服务器出货量



资料来源：Trendforce、湘财证券研究所

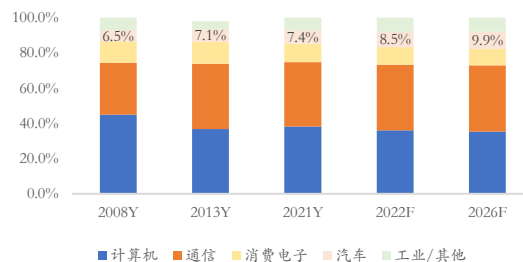
图 4 全球新能源车销量



资料来源：Cleantechnica、湘财证券研究所

根据 IC insights 于 2022YQ3 更新的《麦克林报告》显示，通信、计算机及消费电子仍为半导体下游的主流需求，需求占比合计超过 85%。

图 5 半导体下游需求分布

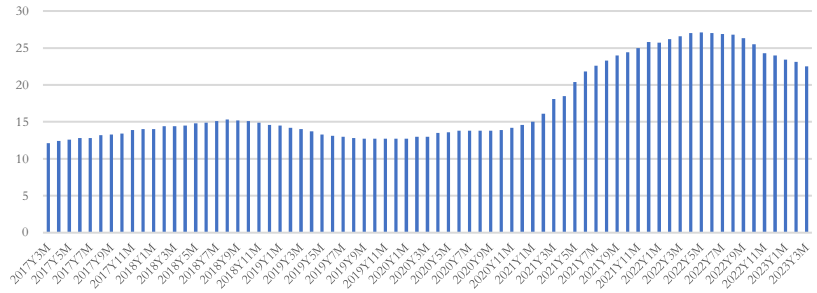


资料来源：IC INSIGHTS、湘财证券研究所

2 芯片及半导体元器件交期下降，但价格或企稳

受半导体下游主流需求依旧不振影响，年初至今全球芯片交货周期持续下滑，Susquehanna Financial Group 统计数据显示 2023 年 3 月，全球芯片交货周期相较于 2022 年 5 月缩短超过一个月。

图 6 芯片交期数据（周）



资料来源：Susquehanna Financial Group、湘财证券研究所

主流消费电子产品市场需求仍然不振，但相较于 2022Q4，模拟芯片交期趋于平稳；中高端 MCU 及蓝牙模块的交期持续缩短，但部分产品价格有企稳回升趋势。车规元器件受下游需求驱动，交期依旧较长，但价格与上个季度持平。分产品来看，8 位/32 位高端 MCU 产品的交期为 26-52 周，多数产品的交期持续下降。汽车 MCU 交期仍高于 40 周，英飞凌的车规级 MCU 仍处于配货状态，但已连续两个季度价格持平。模拟芯片中，传感器交期结束下滑态势，且价格有企稳回升趋势。汽车模拟和电源产品交期仍高于 40 周，但交期时长及价格趋于稳定。分立器件产品中，低压 Mosfet 部分产品交期有下滑趋势，高压 Mosfet 及 IGBT 交期仍稳定在 40 周左右。

表 1 芯片货期-MCU 及模拟芯片

	厂商	2022Q2 货期	2022Q3 货期	2022Q4 货期	2023Q1 货期	交期趋势	价格趋势
8 位 MCU	Cypress	45-52	45-52	45-52	26-52	持平	持平
	微芯	52+	52+	36-52+	36-52+	下降	持平
	恩智浦	紧缺	配货状态	35-52	35-52	下降	持平
	瑞萨	52	52	40	40	下降	上升
	ST	紧缺	配货状态	48	48	下降	持平
32 位 MCU	Cypress	45	45	45	26-52	下降	持平
	微芯	52	52	36-52	36-52	下降	持平
	恩智浦	紧缺	配货状态	26-52	26-52	下降	持平
	瑞萨	52	52	40	40	下降	上升
	ST	40	40	22	20-26	下降	持平
汽车 MCU	瑞萨	45	45	45	45	持平	持平
	ST	紧缺	配货状态	40-52	40-52	持平	持平
	英飞凌	紧缺	配货状态	配货状态	配货状态	持平	持平

资料来源：富昌电子、湘财证券研究所

表 2 芯片货期—分立器件&射频/无线芯片

模拟芯片							
传感器	艾迈斯	8-38	8-38	8-38	8-38	持平	依据市场进行选择调整
	博世	30-52	24-40	12-20	12-20	持平	持平
	英飞凌	18-52	18-52	18-52	18-52	持平	上升
	恩智浦	16-52	16-52	16-52	16-52	上升	上升
	ST	36-40	36-40	12-24	12-24	下降	持平
	安森美	18-52	18-52	18-52	18-52	上升	上升
	罗姆	24-52	24-52	24-52	24-52	上升	上升
开关稳压器	达尔科技	25-45	25-45	25-45	25-46	持平	持平
	英飞凌	40-52	40-52	40-52	40-52	持平	持平
	Maxim	20-30	20-35	-	-	-	-
	微芯	40-50	40-50	40-50	40-50	持平	上升
	瑞萨	40-50	40-50 (部分 26 周)	36-40	36-41	下降	上升
	ST	40-50	40-50	40-50	40-50	持平	持平
	罗姆	50	50	50	50	持平	持平
汽车模拟和电源	英飞凌	45-52	45-52	45-52	45-52	持平	持平
	恩智浦	45-52	45-52	45-52	45-52	持平	上升
	ST	40-52	40-52	40-52	40-52	持平	持平
分立器件							
低压 MOSFET	达尔科技	44-52	48-54	40-54	26-54	下降	持平
	英飞凌	52-65	52-65	26-54	26-54	下降	持平
	安森美	47-52	47-52	36-52	36-52	下降	上升
	安世半导体	47-52	47-52	47-52	47-52	持平	上升
	ST	50-54	50-54	50-54	50-54	持平	持平
高压 MOSFET	英飞凌	52-65	50-54	50-54	50-54	持平	持平
	IXYS	50-54	50-54	50-54	50-54	持平	持平
	安森美	36-52	36-52	36-52	36-52	持平	上升
	ST	47-52	47-52	47-52	47-52	持平	持平
IGBT	英飞凌	39-50	39-50	39-50	39-50	持平	上升
	IXYS	50-54	50-54	50-54	50-54	持平	持平
	ST	47-52	47-52	47-52	47-52	持平	持平
	安森美	39-52	39-52	39-52	39-52	持平	持平
射频和无线芯片							
蓝牙模块	英飞凌+赛普拉斯	26-36	26-36	26-36	26-36	下降	上升
	微芯	24-26	24-26	24-26	24-26	持平	上升
	MuRata	52-64	52-64	26-50	26-50	下降	持平
	安森美	16-30	16-30	16-30	16-30	上升	持平
	松下	39-40	39-40	39-40	39-40	下降	持平
	ST	30-40	30-40	20-25	20-25	下降	上升
WI-FI 模块	微芯	24-26	24-26	24-26	24-26	下降	上升
	MuRata	52-64	52-64	26-50	26-50	上升	持平
RFID	迈来芯	14-16	14-16	14-16	14-16	持平	持平
	松下	14-16	14-16	14-16	14-16	持平	持平
	ST	30-40	30-40	30-40	30-40	持平	持平
	恩智浦	26-52	26-52	26-52	26-52	上升	上升

资料来源：富昌电子、湘财证券研究所

3 投资建议

传统消费电子领域需求复苏预期转强，但销售端尚未出现显著改善，行业龙头企业仍位于主动去库存、削减资本开支阶段，建议紧密关注消费电子终端需求的变动，上游半导体设计龙头的库存及成本变动。汽车智能化渗透率提升及出口增长驱动板块需求稳步增长，建议关注车规级 MOSFET 及

SIC 功率器件的国产化进程。2023 年数字化建设在多领域的稳步推进及人工智能大数据模型的多领域商用，为产业链发展带来新动能，预期将持续提振传感器、CPU、GPU、存储等多种半导体硬件的市场需求。建议持续关注半导体行业，维持行业增持评级。

4 风险提示

下游市场需求不及预期；研发进展不及预期；宏观政策变化不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深 300 指数）

- 买入：**未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持：**未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性：**未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持：**未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；
- 卖出：**未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上。

重要声明

湘财证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。

本研究报告仅供湘财证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告由湘财证券股份有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但对上述信息的来源、准确性及完整性不做任何保证。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。

在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告版权仅为湘财证券股份有限公司所有。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。